

株式会社アドバンテスト
会社説明会

2011年4月27日
代表取締役 兼 執行役員社長 松野 晴夫

2010年度 決算報告
3期ぶりの通期黒字化
を達成

業績の概要

ADVANTEST.

(単位: 億円)

	2009 年度	2010年度								
		1Q	2Q	3Q	4Q			通期		
					1月発表 の予想	実績	前期比 (%)	1月発表 の予想	実績	前期比 (%)
受注高	677	308	233	213	196	336	+57.3	950	1,090	+60.9
売上高	532	235	286	254	225	221	-13.2	1,000	996	+87.2
売上原価	273	119	149	135	-	108	-20.1	-	511	+87.4
売上総利益	259	116	137	119	-	113	-5.3	-	485	+86.9
営業利益	-116	18	29	12	5	2	-87.0	65	61	-
営業外収支	17	-2	-4	-2	-	3	-	-	-5	-
税引前純利益	-99	16	25	10	7	5	-59.5	58	56	-
当期純利益	-115	8	18	7	2	-1	-	35	32	-
受注残	203	276	223	182	153	296	+63.3	153	296	+46.1

4

All Rights Reserved - Advantest Corporation

2011/4/27

○ 2010年度の業績概要

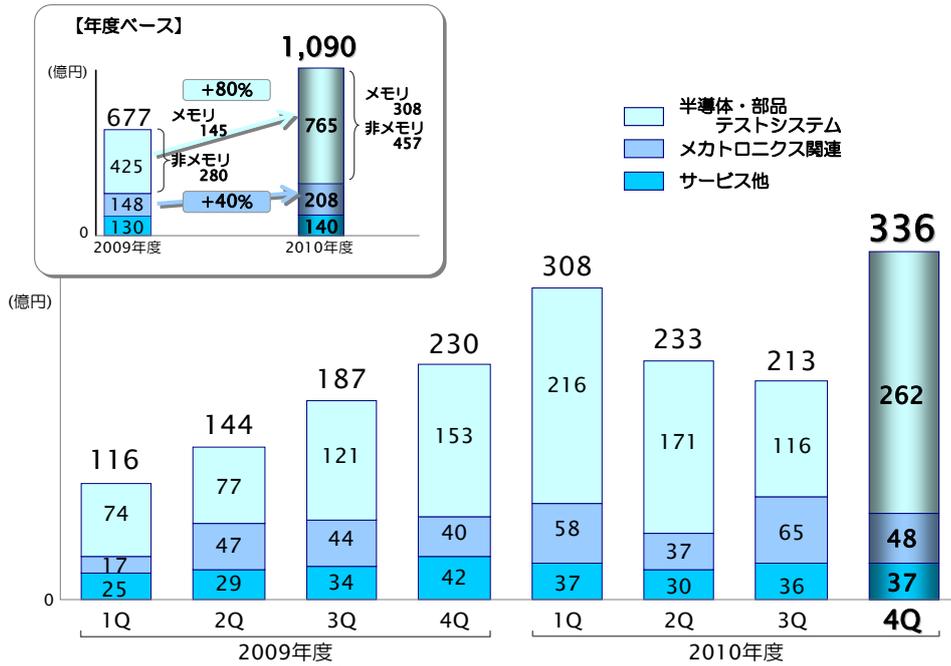
- ・ 受注高 1,090億円
前年度比 61%増と大きく伸びた
特に第4四半期が、非メモリ・テスト向けを中心に好調
- ・ 売上高 996億円
DRAM市況の軟化に伴い、第2四半期をピークに下期やや落ち込んだものの、通期では前年度比 87%増とこちらも大きく増加

○ その結果、

- ・ 営業利益 61億円
- ・ 当期純利益 32億円
と3期ぶりの最終黒字化を達成した
- ・ また、第4四半期に受注高を伸ばしたことで、受注残は 296億円 となった

- なお、2011年度業績予想の開示は、第1四半期以降の見通しが不透明なため、差し控えた。見通しがつき次第、開示する予定

受注高 事業セグメント別



○ 2010年度の事業セグメント別受注高

- 半導体・部品テストシステム事業
 - ・前年度比80%増 765億円

(主な増加要因)

- ・非メモリ・テストでは、
 - ・MPU向け「T2000」が好調
- ・メモリ・テストでは、
 - ・上期はPC用DRAMの好況によって、
 - ・下期はモバイルDRAM需要の増加を背景として、堅調

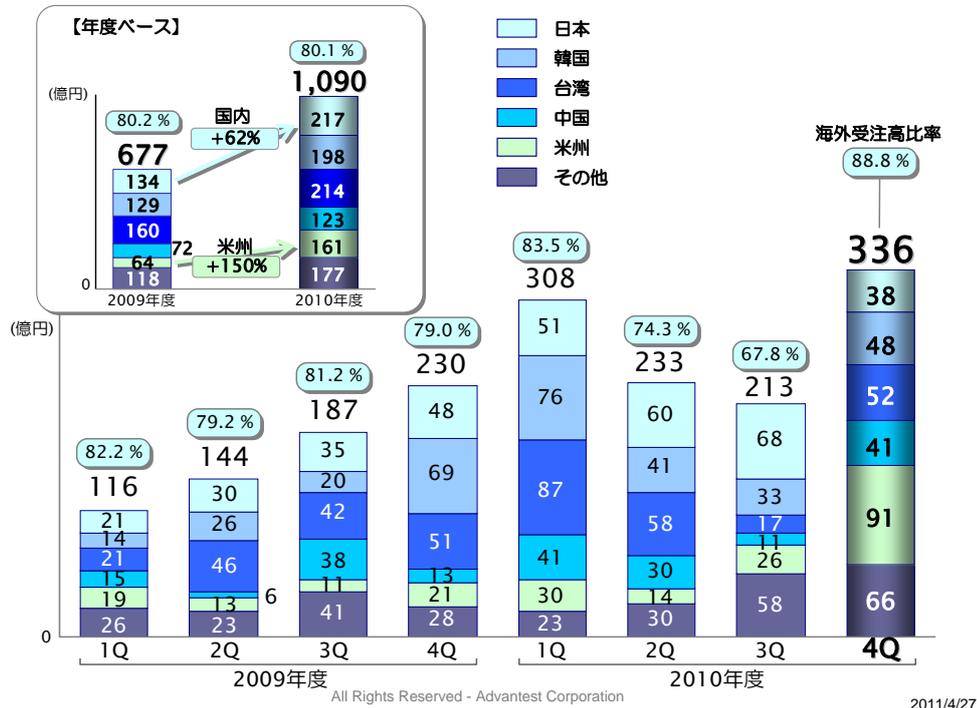
- メカトロニクス関連事業
 - ・前年度比40%増 208億円

(主な増加要因)

- ・デバイス・インタフェース
 - ・テスト受注増加に連動して堅調
- ・テスト・ハンドラ
 - ・アナログIC向け需要が好調

受注高 地域(出荷先)別

ADVANTEST.



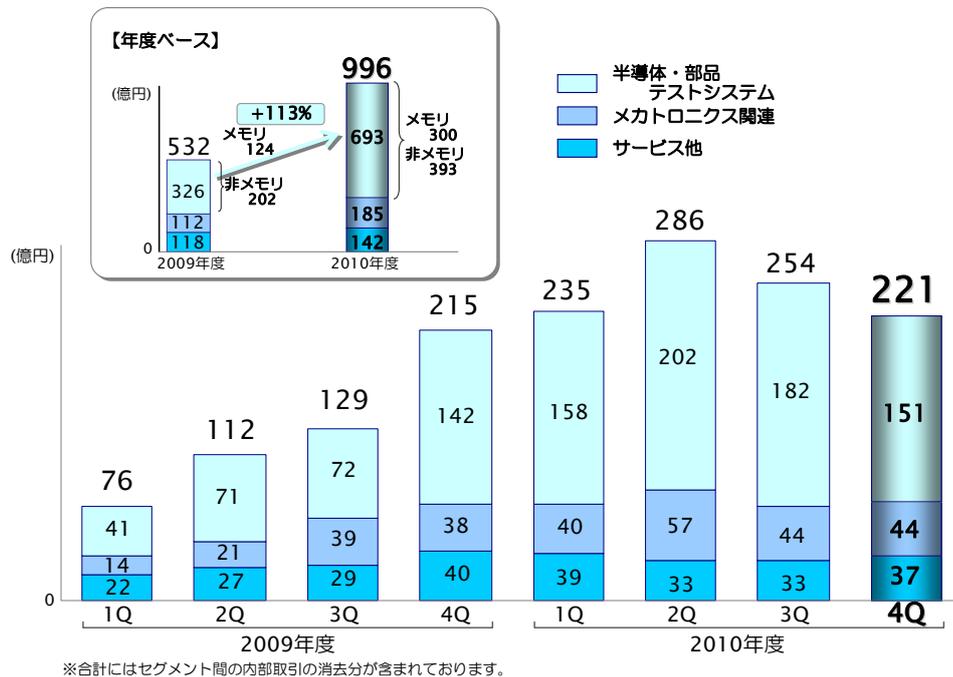
- 地域別受注高
 - ・米州、日本など各地で受注増加

- 米州
 - ・前年度比150%増 161億円
 - (主な増加要因)
 - ・MPU向けの「T2000」が中心

- 日本
 - ・前年度比62%増 217億円
 - (主な増加要因)
 - ・モバイルDRAM向けにメモリ・テスト需要が増加

売上高 事業セグメント別

ADVANTEST



7

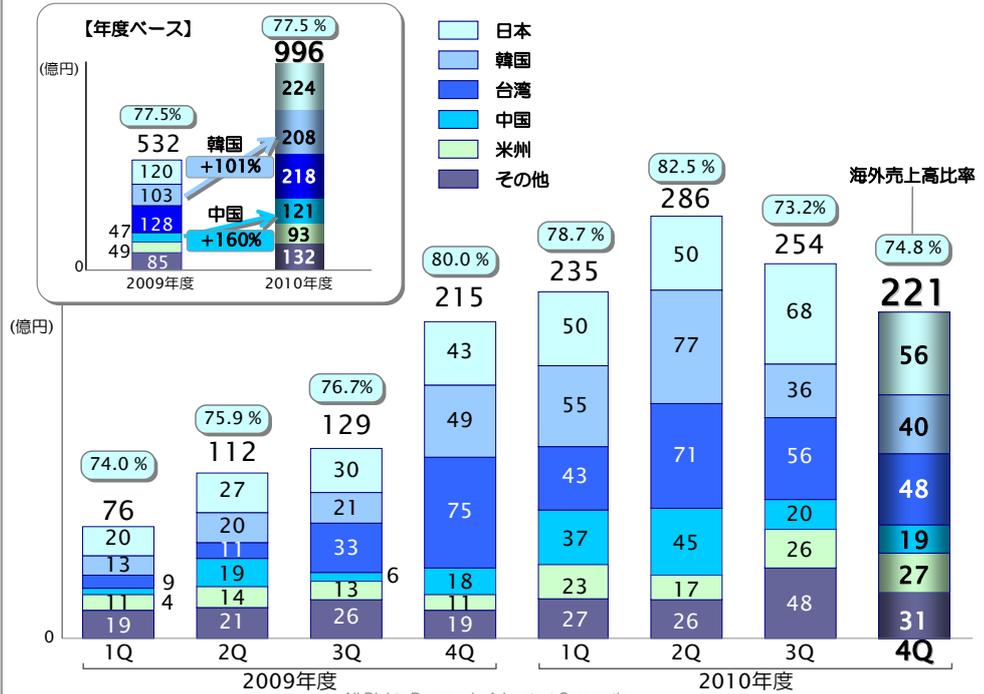
All Rights Reserved - Advantest Corporation

2011/4/27

- 事業セグメント別売上高
- 半導体・部品テストシステム事業
 - ・前年度比113%増 693億円
 - (主な増加要因)
 - ・非メモリ・テストが、MPUやMCU向けを中心に堅調
 - ・メモリ・テストも、PC用DRAMやモバイルDRAM向けの投資増を背景に、前年度比で2倍以上伸びた

売上高 地域(出荷先)別

ADVANTEST.

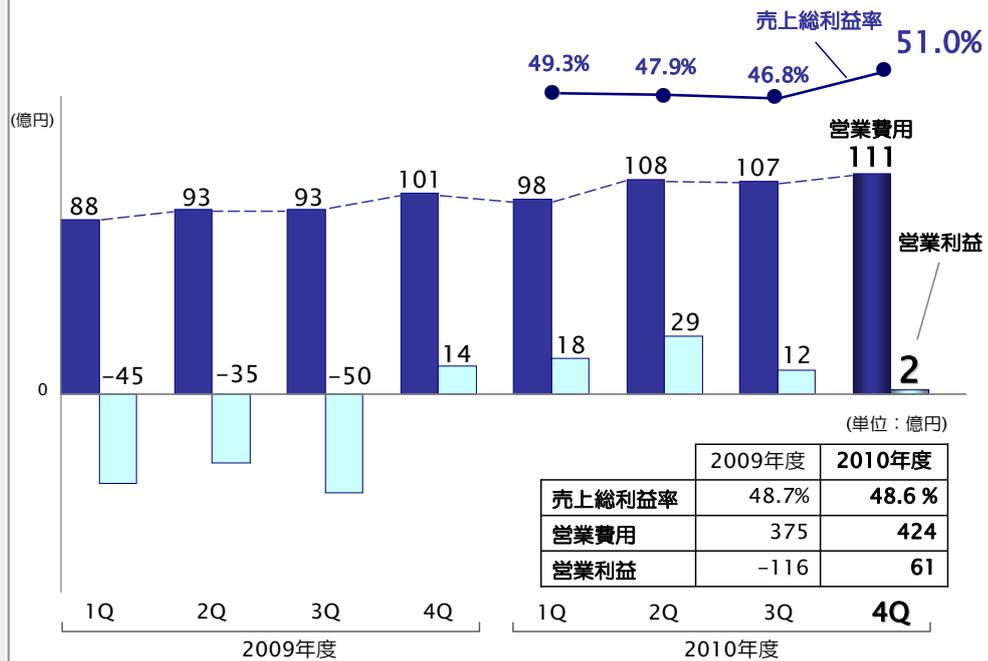


○ 地域別売上高

- ・ 全地域とも順調に増加
- ・ 特に、有力メモリメーカーの生産拠点多い東アジアでの伸び率が顕著となった

営業利益/売上総利益率/営業費用

ADVANTEST.

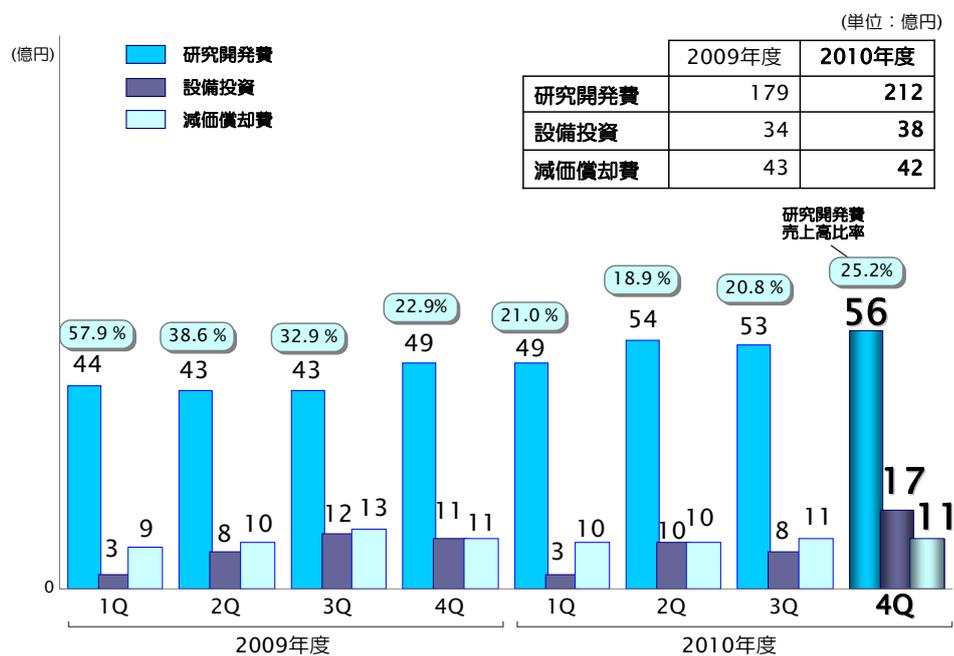


○ 2010年度営業利益について

- ・ 売上総利益率
前年度と同等、48.6%
- ・ 営業費用
売上増加に伴い、前年度比13%増加 424億円
- ・ 営業利益
前期比177億円増 61億円
通期での黒字化を達成

研究開発費／設備投資／減価償却費

ADVANTEST.



○ 研究開発費

- ・前年度比18%増の 212億円

- ・研究開発は当社の生命線であり、
今後も一定水準以上の投資を継続する

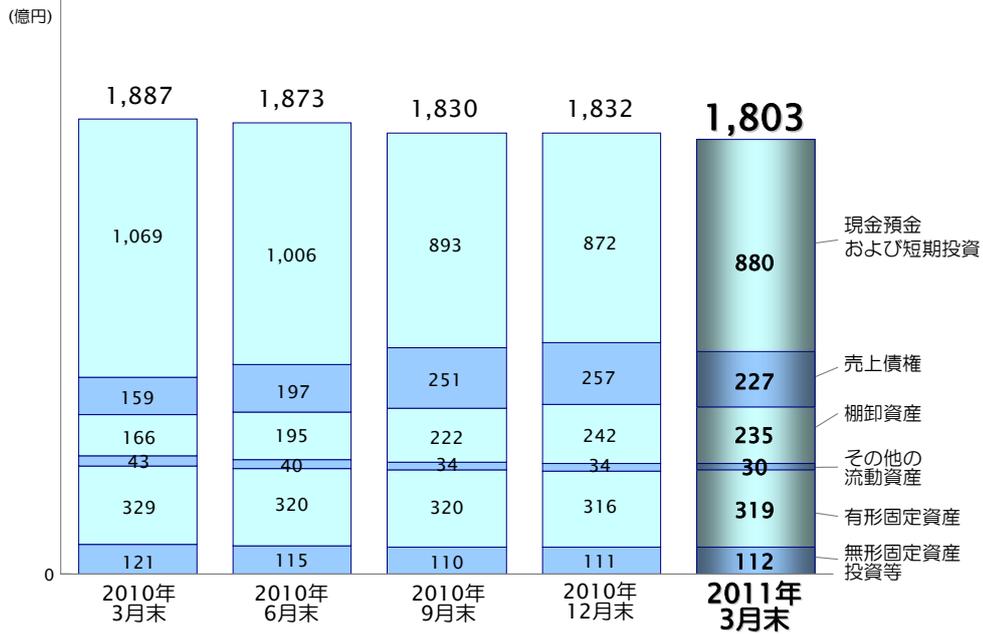
○ 設備投資

- ・前年度同等の、38億円に抑制

- ・主な用途は、開発・生産部門の業務効率向上に向けた
設備の更新

バランス・シート <資産の部>

ADVANTEST.



○ 2011年3月末時点のバランス・シート

○ 資産の部

・ 現金預金および短期投資

2010年8月に実施した約103億円の自己株式取得などにより
2010年3月末比 189億円減少

・ 売上債権は、
売上高の増加に伴い

2010年3月末比約1.4倍の 227億円

・ 棚卸資産は、

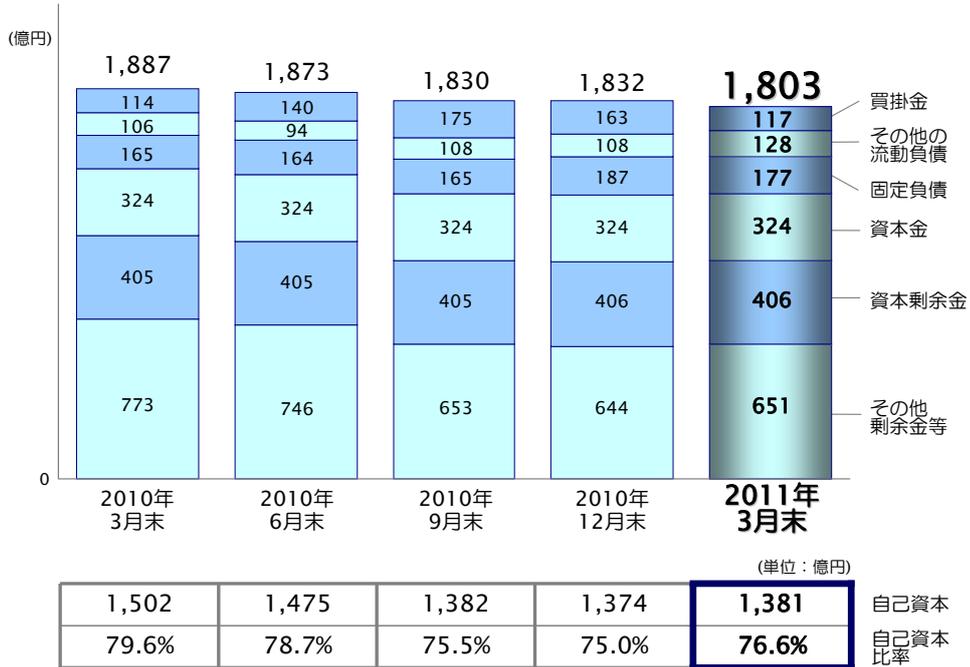
受注の増加を背景として生産量が伸びたことで
2010年3月末比約1.4倍の 235億円

○ これらの結果、総資産は、

前期末から84億円減の 1,803億円

バランス・シート <負債・資本の部>

ADVANTEST.



○ 負債・資本の部

- ・ 自己資本 1,381億円
2010年8月に実施した自己株式取得などにより
2010年3月末比 121億円減
- ・ その結果、自己資本比率は
前期からマイナス3ポイントの76.6%

以上、2010年度の決算についてご説明いたしました。

2011年度 事業展望
過去の強みを活かしつつ
新たな成長ステージへ

1 半導体テスト市場でのシェア拡大

<非メモリ・テスト> T2000カバレッジ拡大を活かし
シェア向上

<メモリ・テスト> 高シェアの維持

2 収益性のさらなる改善

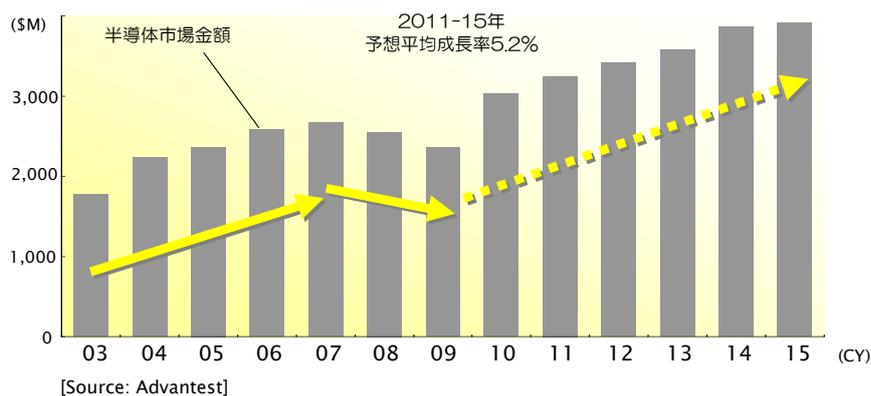
- ・設計資産の転用による開発工期の短縮
- ・調達オペレーションの最適化とグローバル生産体制の編成
- ・原価低減、経費抑制の取り組み継続

3 持続的成長のための事業育成

- 2010年度の当社の業績を改めて振り返ると、メモリ・テスト市場では、DRAM価格の低下やパソコン市場の減速の影響を受け、期待よりもやや低調な結果に留まった。一方で、非メモリ・テスト市場は期を通じて堅調で、その結果、当社は順調に業績を回復することができた
- 2011年度は、先の震災の影響もあり、先々不透明な状況であるが、世界全体の経済は堅調な成長が期待されており、当社の業績もまだまだ伸ばしていける環境であると捉えている
- ここからは、2011年度の当社の主な施策について、お話しします

■半導体市場の規模は、搭載機器／用途の拡大、数量／容量の増大、そして搭載機器の新興国への浸透などにより成長の一途

■市場の成長と同時に、“信頼性”に対する保証ニーズもますます強くなっていく



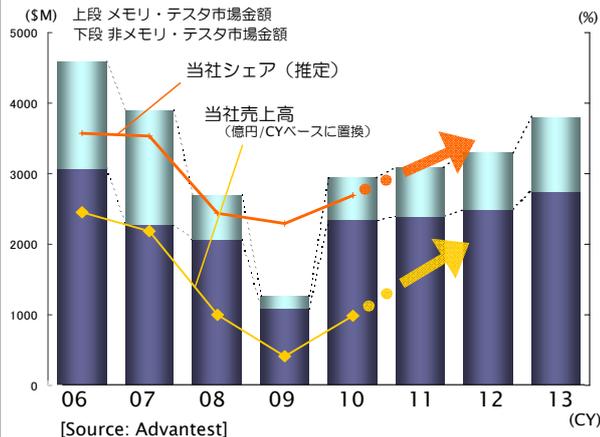
○ はじめに、当社を取り巻く環境について

- ・近年の半導体市場は、
 - ・半導体を搭載する機器や用途の拡大
 - ・半導体搭載機器 1 台あたりの搭載数量／容量の増大
 - ・半導体搭載機器の新興国への浸透
 などを背景として成長を続けており、今後も情報化社会の進展につれて、ますます成長の一途をたどるものと思われる
- ・そして、半導体の用途が、自動車や社会的インフラを含めた広範な分野へと広がるにつれて、半導体にはこれまで以上に高信頼性が要求されていく
- ・今後、半導体テストによる信頼性保証ニーズも、ますます強くなっていくものとする

■半導体テスタ市場は2010年に大きく回復 今後も緩やかな成長基調で推移すると予想

半導体需要の中心は
PCやデジタル家電

半導体の用途は
より広範な機器へ



半導体市場の中でも、

- ・携帯型情報端末のさらなる普及と利便性向上需要 (高速処理化・大容量化)
- ・自動車のエレクトロニクス化の進展
- ・電力利用効率の向上ニーズ (省電力化、電力制御)

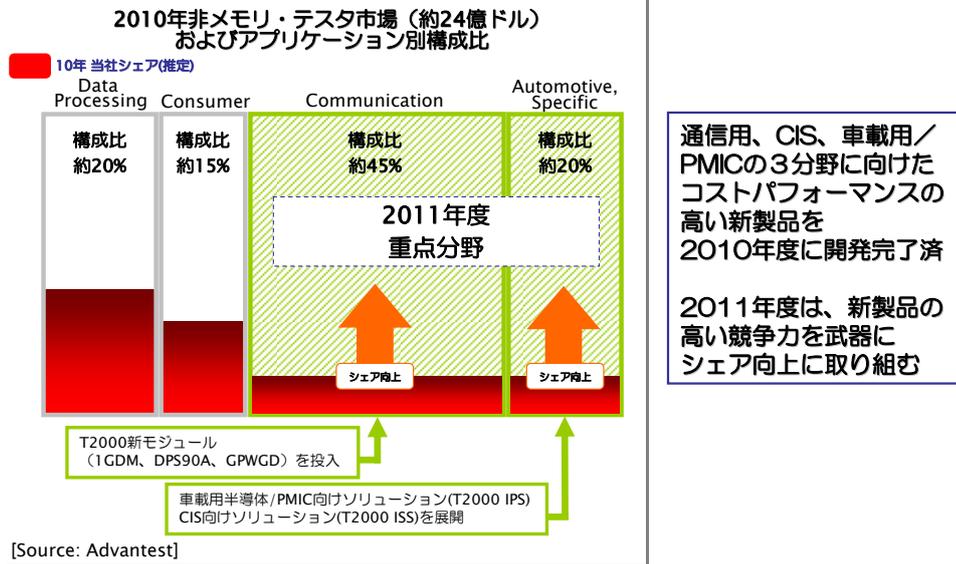
などを背景とする、成長アプリケーション分野の取り込みが、業績伸長のドライバーとなる

○ 次に、今後の半導体テスタ市場に対する当社の見方

- ・ スライドのグラフは、半導体テスタ市場規模、当社の売上高、および当社シェアの推移を表したものの
- ・ これまでの数年間、特にメモリ・テスタ市場を中心に市場規模が縮小傾向にあったが、2010年は久しぶりにテスタ市場が拡大傾向へと反転
- ・ 2011年以降についての予測は難しいものの、今後は緩やかな成長を維持すると予想

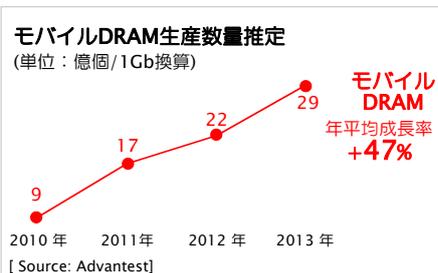
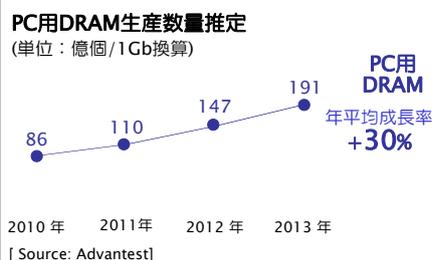
○ 今後、当社が業績を伸ばしていくためには、半導体市場の中の成長分野を重点的に取り込み、シェアを高めることが重要と考えている

■ 通信用半導体、CMOSイメージセンサ（CIS）、
車載用半導体／パワーマネジメントIC（PMIC）に注力



- まず、非メモリ・テスト市場では、
シェア拡大に引き続いて注力していく
 - 2010年の当社の非メモリ・テスト市場でのシェアは
約20%弱
 - ・ しかしこの図のように、規模の大きな通信用半導体向けや、
車載用半導体および特定半導体向けの市場でのシェア獲得が
これまでの課題
 - ・ これらの市場の攻略に向け、当社はこれまで、
競争力ある新製品の開発に取り組んできた。
その結果、コストパフォーマンスの高い製品群を
2010年度中に揃えることができた
 - ・ そして2011年度は、その新製品を武器に
 - ・ 通信用半導体
 - ・ CMOSイメージセンサ
 - ・ 車載用半導体とパワーマネジメントIC
- の3つの市場に特に注力し、シェア向上に取り組む

■DRAM用テスト需要は堅調と予測 2011年度はモバイル機器用のDRAMが牽引



モバイルDRAM向けのテスト需要は、

- ・デバイスの数量増加
- ・テストタイムの増加
- ・デバイスの速度向上

を背景に、今後ますます伸びていくと思われる

この市場に向けて、当社はすでに対応製品を他社に先行して投入済。この優位性を今後も維持し、シェアをさらに伸ばす



- 次に、メモリ・テストの市場では、現状保有している高シェアの維持・拡大を目指す
- 当面のメモリ・テスト市場は、スマートフォンやタブレット型PCに搭載されるモバイルDRAM向けの需要に牽引されると思われる
 - ・ モバイルDRAMの生産量は、2010年からの3年間で1ギガビット換算で約3倍強の規模へ成長すると推定
 - ・ またモバイルDRAMのテストタイムは、PC用DRAMより相対的に長い性質がある
 - ・ また、今後モバイルDRAMは高速化が進むため、メモリ・テストには量産能力と高速試験性能の双方がますます求められる
- 当社は業界最高のスループットを誇る製品を、他社に先駆け市場投入済み。この優位性を活かし、メモリ・テスト市場のシェアをさらに伸ばしていく

■スピード化・スリム化をさらに追求し 事業環境の変化への俊敏な対応を図る

- ・ 設計資産の転用による開発工期の短縮
- ・ 調達オペレーションの最適化と
グローバル生産体制の編成
- ・ 原価低減、経費抑制の取り組み継続

- 次に、収益性改善の取り組みについて
- 売上の向上と並行して、
収益性のさらなる改善にも継続して取り組む
 - ・ 開発部門においては、市場ニーズへの対応力強化に向け、これまで蓄積した設計資産の転用による、開発工期短縮に取り組む
 - ・ 生産関連部門では、調達オペレーションの最適化によるコストダウン推進と、顧客要求への迅速な対応のためのグローバル生産体制の編成などに取り組む
 - ・ これらに限らず、利益の増大化と機会損失予防の取り組みを全社的に進め、収益性改善を図っていく

■ 広範な事業領域で複数プロジェクトを進行中 2011年度は各市場での地歩を一層固めていく

< 先行プロジェクトの状況 >

プローブ・カード

大手メーカーでの採用実績獲得
多品種対応への柔軟性を武器に更なる
拡販をはかる



CDSEM

微細化が進む半導体製造に不可欠な
次世代フォトマスクを高精度に検査可能、
業界をリード



3Dイメージング解析システム

自動車業界で採用実績獲得
それ以外の市場に向けても販売強化中



NPX

NANDフラッシュメモリ・テスト

顧客ニーズに応える製品を開発中

- 3つ目は、新規事業の育成について
 - 現在、さまざまな分野で複数のプロジェクトを進行中
全貌はお話しできないが、
 - ・ プローブ・カード
 - ・ CDSEM
 - ・ テラヘルツ・3Dイメージング・システム
 - ・ NANDフラッシュメモリ・テスト
- などで昨年度、一定の成果を得ることができた
- 今年度も、当社の持続的成長のため、新規事業の育成や
開発プロジェクトの推進を引き続き強化していく

- 2011年度は活動最終年度
目標は「3年度（2009-11年度）合計での黒字化」



- 全社運動「1000Days」の状況
 - ・ 当社は、2009年7月より全社運動「1000Days」を推進中
 - ・ 目標である「3年度合計での黒字化」に向けて、
 - ・ 全社員が、7つの”S”をキーワードに、一日一日を大切にすると共に、中期的な視野を持って、改善に取り組む活動。
 - ・ 全社でこれまで1,000件を超えるテーマに取り組んできた
- 2010年度は黒字化を果たしたが、これにとどまることなく全社運動の最終年となる2011年度に、更なる業績の向上に向けて取り組んでいく

■当社の被害は軽微

今後は生産能力の確保と顧客納期の遵守に注力

これまでの状況

- ・従業員への人的被害なく、施設への損傷も軽微
群馬・埼玉地区の事業所は、震災直後より操業復帰
仙台地区の事業所も、4月に操業再開済み
- ・物流の混乱で、2010年度中の売上計上に若干の影響

現在実施中の施策

- ・サプライヤーと協業して、調達体制を緊急整備
- ・短期間に調達性が回復できない部材については代替措置を実施中
- ・夏季操業時のシフト勤務、夏季休暇時期の調整を検討中

⇒状況の変化や社会的要請への対応を踏まえつつ
生産能力を確保し、顧客納期の遵守をはかる

○ 最後に、3月11日に発生した東日本大震災の影響について

- ・当社への直接の被害は軽微
 - ・最も影響の大きかった仙台の事業所も
4月上旬に操業再開済み
 - ・物流の混乱で、2010年度の売上計上に
若干の影響はあった
- ・しかし、東北・北関東地方には当社のサプライヤーも多く存在。
今後の調達性に関して不透明な状況が継続している
- ・今後の顧客要求に応えるための生産能力確保を緊急課題とし、
調達体制の整備を推進中
- ・また将来の電力不足による操業度低下の懸念については、
社会的要請への対応を踏まえつつ、臨機応変に対応可能なよう
さまざまな施策を検討中

このたびの東日本大震災で
被災された方々に、
謹んでお見舞い
申し上げますとともに、
被災地の一刻も早い復旧を
心からお祈り申し上げます。

ご注意

- ◆ 当社は米国会計基準を採用しております。
- ◆ 将来の見通しに関する記述について
本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているもの又は暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されています。